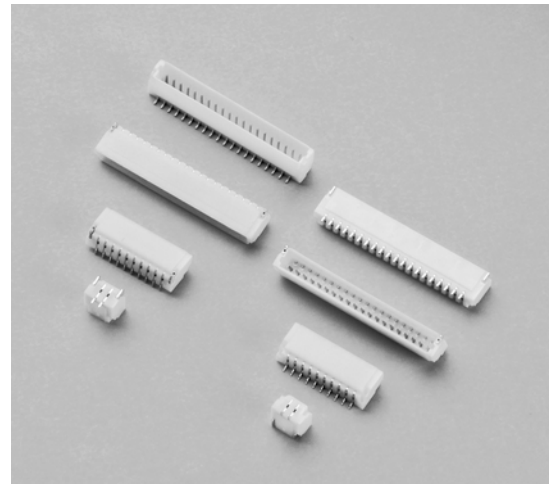


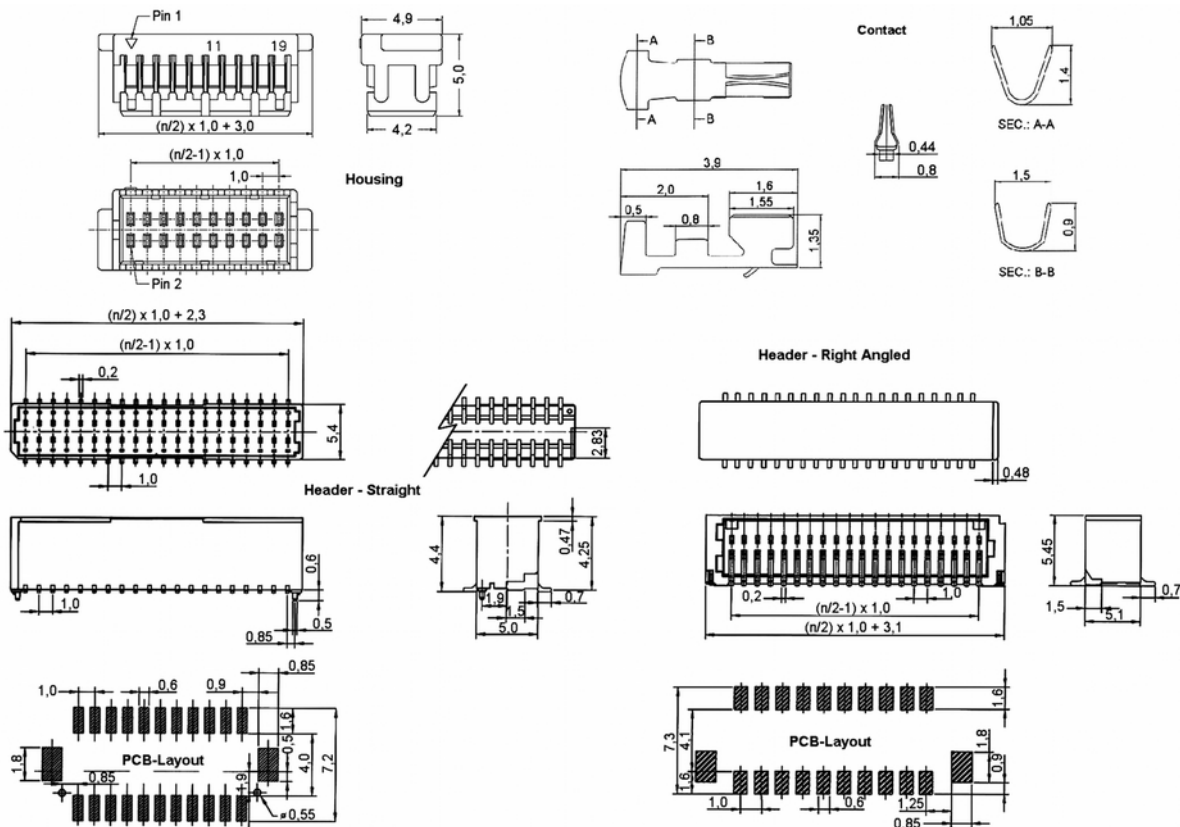
SMT-Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,00mm, stehend/liegend SMT Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.00mm Pitch, Vertical/Horizontal

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 28 ... 32
Applicable wire Gauge	AWG 28 ... 32
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ im Auslieferungszustand
Contact Resistance	< 20mΩ at initial state
Isolationswiderstand	> 100MΩ
Insulation Resistance	> 100MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennspannung	50V _{AC}
Voltage Rating	50V _{AC}
Nennstrom	1A bei AWG 28
Current Rating	1A at AWG 28
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS



Series	Contacts*	Type*	Plating
5111	20 20/30/40/50	3 1 Buchsengehäuse Housing 2 Buchsenkontakte Crimp contacts 3 Stifteleiste gerade Straight pin header 4 Stifteleiste gewinkelt Right-angled pin header	50 50 Verzinkt (Standard) für Gehäuse nicht erforderlich Tin plated (Standard) (not necessary for housings)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

